

第19回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 29 年 9 月 5 日(火) 10:30~16:10

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室 (東京都中央区)

時間	題目	講演者
10:30~ 12:00	司会 佐名川 佳治(パナソニック(株))	
	『成形接合:表面処理とインサート成形を利用した金属・樹脂直接接合』 (45分)	○木村 文信、門屋 祥太郎、 梶原 優介(東京大学)
	『パワー半導体向け高耐熱封止樹脂の 開発状況』 (45分)	○松尾 誠(住友ベークライト(株))
12:00~ 13:00	昼食休憩	
13:00~ 13:10	委員会議事	
13:10~ 14:40	司会 阪元 智朗(オムロン(株))	
	『0201 チップ部品向けのソルダーペースト 開発』 (45分)	○吉澤 慎二、田中 沙佑美、 奥村 聡史、岩渕 充、柴田 誠治 (株)タムラ製作所))
	『最新トレンド!次世代汎用ソルダペーストの ご紹介』 (45分)	○高木 和順(千住金属工業(株))
14:40~ 14:50	休憩	
14:50~ 16:10	司会 山中 公博(中京大学)	
	『新世代エレクトロニクスの可能性を切り開く 新ダイレクトパターニングめっき技術』 (45分)	○伊東 正浩(日本エレクトロプレイ ティング・エンジニアーズ(株))
	『ニューロモーフィック・デバイスの実装 技術への要求と課題』 (45分)	○森 裕幸、久田 隆史、松本 圭司、 堀部 晃啓、宮澤 理沙 (日本アイ・ビー・エム(株))

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。